

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 9 月 22 日 (22.09.2005)

PCT

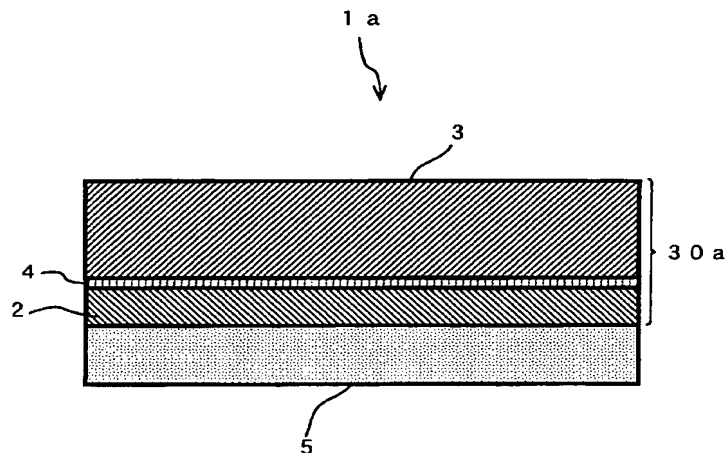
(10) 国際公開番号  
WO 2005/087489 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: B32B 15/08, H05K 1/03, 1/09, 3/00, 3/46
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/004501
- (22) 国際出願日: 2005 年 3 月 15 日 (15.03.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2004-075235 2004 年 3 月 16 日 (16.03.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三井金属鉱業株式会社 (MITSUI MINING & SMELTING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1418584 東京都品川区大崎一丁目 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 永谷 誠治 (NAGATANI, Seiji) [JP/JP]; 〒3620013 埼玉県上尾市鎌倉橋 6 5 6-2 三井金属鉱業株式会社 銅箔事業本部 銅箔事業部内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 吉村 勝博 (YOSHIMURA, Katsuhiko); 〒3300854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2 丁目 5-4 大宮 F ビル 吉村国際特許事務所 Saitama (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

[続葉有]

(54) Title: CARRIER FOIL-ATTACHED ELECTROLYTIC COPPER FOIL PROVIDED WITH INSULATION LAYER FORMING RESIN LAYER, COPPER-CLAD LAMINATED SHEET, PRINTED CIRCUIT BOARD, PRODUCTION METHOD FOR MULTILAYER COPPER-CLAD LAMINATED SHEET AND PRODUCTION METHOD FOR PRINTED CIRCUIT BOARD

(54) 発明の名称: 絶縁層形成用の樹脂層を備えたキャリア箔付電解銅箔、銅張積層板、プリント配線板、多層銅張積層板の製造方法及びプリント配線板の製造方法



(57) Abstract: A technique of using a copper foil not roughened as a printed circuit board, especially a method using a carrier foil-attached electrolytic copper foil. A carrier foil-attached electrolytic copper foil or the like is used, which is provided with an insulation layer forming resin layer, and which is characterized by being provided on the surface of a carrier foil with a joint interface layer, on the joint interface layer with an electrolytic copper foil layer smooth on the both surfaces thereof, and on the electrolytic copper foil with a resin layer. Resin compositions constituting this resin layer include 20-80 pts.wt. of epoxy resin (including a curing agent), 20-80 pts.wt. of aromatic polyamide resin polymer soluble in a solvent, and a curing accelerator added in a proper amount as needed.

(57) 要約: 粗化処理を施していない銅箔をプリント配線板に用いる技術であり、特にキャリア箔付電解銅箔を用いる方法を提供する。そのため、絶縁層形成用の樹脂層を備えたキャリア箔付電解銅箔であって、当該キャリア箔付電解銅箔は、キャリア箔の表面に接合界面層を備え、その接合界面層上に両面が平滑な電解銅箔層を備え、当該電解銅箔層の上に樹脂層を備

[続葉有]

WO 2005/087489 A1



NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,  
SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,  
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

えることを特徴とする絶縁層形成用の樹脂層を備えたキャリア箔付電解銅箔等を採用する。そして、この樹脂層を構成する樹脂組成物には、20～80重量部のエポキシ樹脂（硬化剤を含む）、20～80重量部の溶剤に可溶な芳香族ポリアミド樹脂ポリマー、及び、必要に応じて適宜量添加する硬化促進剤からなるもの等を用いる。